

ポリイミドの基礎・合成・材料設計の ポイントおよび応用展開

1名分料金で
2人目無料

セミナーURLはこちら→ <https://www.rdsc.co.jp/seminar/250284>

- ◆日時：2025年02月13日(木) 12:30～16:30
- ◆【アーカイブ配信受講：2/14(金)～2/21(金)】の視聴を希望される方は、
⇒こちら <https://www.rdsc.co.jp/seminar/250284> からお申し込み下さい。
- ◆受講料：1名につき49,500円(税込、資料付)

会員(案内)登録していただいた場合、通常1名様申込で49,500円(税込)から

- ・1名で申込の場合、**46,200円(税込)**へ割引になります。
- ・2名同時申込で両名とも会員登録をしていただいた場合、**計49,500円(2人目無料)**です

セミナーお申込みFAX

03-5857-4812

※お申込み確認後は弊社よりご連絡いたします。

●講師：東レ(株)シニアフェロー 博士(工学)富川 真佐夫 氏 【ご専門】耐熱高分子、感光材料

【ご経歴】

1991年に高分子学会賞
2009年 日本化学会 化学技術賞
2010年、2017年 地方発明表彰
2015年 全国発明表彰
2018年 ベストペーパー賞
パンパシフィック
マイクロエレクトロニクスシンポジウム
2019年 高分子学会フェロー
2020年 文部科学大臣表彰
フォトポリマー学会業績賞

【受講対象】

・ポリイミドなどの製造・研究・開発業務に携わり、
さらに深く学習したい方

【習得できる知識】

・ポリイミドについて、開発経緯、合成方法、分子構造との関係、機能化、応用について、包括的な解説を行い、ポリイミドについての一通りの知識をつける。

【必要な予備知識】

・有機化学、高分子科学の基礎的なことがあれば好ましい。

【講演の趣旨】

・ポリイミドなど耐熱性高分子の合成方法、構造と物性の関係、感光化や接着などの機能化と材料の応用展開について紹介する。

【プログラム】

1. ポリイミドの定義、歴史
2. ポリイミドの機能化と分子設計
 - 2.1 合成
 - 2.2 ポリイミドの種類(熱硬化、熱可塑、変性)
 - 2.3 硬化条件と物性の関係
 - 2.4 構造と熱安定性の関係
 - 2.5 構造と熱膨張率の関係
 - 2.6 構造と着色の関係
 - 2.7 構造と誘電特性の関係
 - 2.8 感光性ポリイミド
3. ポリイミドの展開
 - 3.1 半導体、電子部品用途
 - 3.2 ディスプレイ用途
 - 3.3 分離膜用途
 - 3.4 電池用途
4. まとめ

『ポリイミド【WEBセミナー】』セミナー申込書 ※ご希望の参加形式にチェックを入れて下さい⇒< LIVE / アーカイブ >

会社・大学			
住所	〒		
電話番号		FAX	

お名前	所属・役職	E-Mail
①		
②		

会員登録(無料) ※案内方法を選択してください。複数選択可。

Eメール 郵送

● セミナーの受講申込みについて ●

必要事項をご明記の上、FAXでお申込み下さい。弊社で確認後、必ず受領のご連絡をいたします。受講用URLは後日お送りいたします。

セミナーお申込み後のキャンセルは基本的にお受けしていませんので、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

お申込み・振込に関する詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/entry>

個人情報保護方針の詳細はHPをご覧ください。
⇒ <https://www.rdsc.co.jp/pages/privacy>